

预成型焊片 嘉泓机械 预成型焊片分切

产品名称	预成型焊片 嘉泓机械 预成型焊片分切
公司名称	西安嘉泓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安户县城西四号路口
联系电话	18729981877

产品详情

预成型焊片轧机

裂纹

焊接PCB在刚脱离焊区时，由于焊料和被接合件的热膨胀差异，在急冷或急热作用下，预成型焊片分切机，因凝固应力或收缩应力的影响，会使SMD基本产生微裂，焊接后的PCB，在冲切、运输过程中，也必须减少对SMD的冲击应力。弯曲应力。

表面贴装产品在设计时，就应考虑到缩小热膨胀的差距，正确设定加热等条件和冷却条件。选用延展性良好的焊料。

预成型焊片轧机：锡银铜SAC305焊料轧机，金锡焊片热压机

型号：JH-RY-60

名称：扎机

用途：主要适用于预成型焊片的轧制

特点：该机采用耐高温材料做轧辊，辊面经过特殊处理，不易粘辊，便于清理。轧制带材 平整光滑。

适用范围：预成型焊片

适应材料宽度：15 mm ~ 60 mm

轧制来料厚度： 0.1mm

轧制厚度：0.02mm

轧制温度： 200

轧制压力： 0.5T

预成型焊片

钎焊料轧机，锡金焊料轧机，锡银铜焊料轧机

型号：JH-RZ-260

名称：预成型焊片陶瓷辊热扎机

用途：主要适用于预成型焊片的轧制加工及锂离子电池电芯的热压定型

特点：该机采用陶瓷材料做轧辊，油缸加斜块控制厚度。轧制带材平整光滑，解决了普通辊的粘辊问题。

适用范围：预成型焊片，预成型焊片分切，锂离子电池电芯

适应材料宽度：20 mm ~ 80 mm

轧制来料厚度： 6mm

轧制厚度：0.05mm

厚度控制：大量程千分表

轧制温度： 300

芯片级封装技术

在BGA(球栅阵列)技术开始推广的同时，另外一种从BGA发展来的CSP封装技术正在逐渐展现它的生力军本色，金士顿、勤茂科技等内存制造商已经推出采用CSP封装技术的内存产品。CSP(Chip Scale Package)即芯片尺寸封装，作为新一代封装技术，它在TSOP、BGA的基础上性能又有了革命性的提升。CSP封装可以让芯片面积与封装面积之比超过1：1.14，已经相当接近1：1的理想情况，尺寸也仅有32平方毫米，约为普通BGA的1/3，仅仅相当于TSOP面积的1/6。这样在相同封装尺寸内可有更多I/O，使组装密度进一步提高，可以说CSP是缩小了的BGA。CSP封装芯片不但体积小，同时也更薄，其金属基板到散热体的有效散热路径仅有0.2mm，大大提高了芯片在长时间运行后的可靠性，其线路阻抗较小，芯片速度也随之得到大幅提高，CSP封装的电气性能和可靠性也相比BGA、TOSP有相当大的提高。在相同芯片面积下CSP所能达到的引脚数明显也要比后两者多得多(TSOP最多304根，BGA以600根为限，CSP原则上可以制造1,000根)，这样它可支持I/O端口的数目就增加了很多。此外，CSP封装芯片的中心引脚形式有效缩短了信号的传导距离，衰减随之减少，使芯片的抗干扰、抗噪性能得到大幅提升，这也使CSP的存取时间比BGA改善15%~20%。在CSP封装方式中，芯片通过一个个锡球焊接在PCB板上，由于焊点和PCB板的接触面积较大，所以芯片在运行中所产生的热量可以很容易地传导到PCB板上并散发出去；而传统的TS

OP封装方式中，芯片是通过芯片引脚焊在PCB板上的，焊点和PCB板的接触面积较小，预成型焊片，芯片向PCB板传热就要相对困难一些。CSP封装可以从背面散热，且热效率良好，CSP的热阻为35 /W，而TSOP热阻40 /W。测试结果显示，预成型焊片轧机，运用CSP封装的芯片可使传导到PCB板上的热量高达88.4%，而TSOP芯片中传导到PCB板上的热能为71.3%。另外由于CSP芯片结构紧凑，电路冗余度低，因此它也省去了很多不必要的电功率消耗，致使芯片耗电量和温度相对降低。目前CSP已经开始应用于超高密度和超小型化的消费类电子产品领域，如内存条、移动电话、便携式电脑、PDA、超小型录像机、数码相机等产品

金锡共晶合金焊料Au80Sn20是一种广泛应用于光电子封装、大功率LED和高可靠性/医用/航空航天电子器件焊接的贵金属焊料，具有熔点高，抗蠕变性好，润湿性好，焊接接头强度高及导热性能好等优点。常制作成预成型焊片用于各类封装结构的连接中，特别适用于可靠性和气密性要求高的光电子封装电子的焊接。

由于Au80Sn20是共晶组织，液相线和固相线重合于一点280 ° C.由其相图可以观察到，成分的细微变化将引起熔点的飘移，从而影响焊接工艺和质量。所以成分比例的控制对焊片的应用有很大影响。

预成型焊片轧机：锡银铜SAC305焊料轧机，金锡焊片热压机

型号：JH-RY-60

名称：扎机

用途：主要适用于预成型焊片的轧制

特点：该机采用耐高温材料做轧辊，辊面经过特殊处理，不易粘辊，便于清理。轧制带材平整光滑。

适用范围：预成型焊片

适应材料宽度：15 mm ~ 60 mm

轧制来料厚度： 0.1mm

轧制厚度：0.02mm

轧制温度： 200

轧制压力： 0.5T

预成型焊片-嘉泓机械-预成型焊片分切由西安嘉泓机械设备有限公司提供。西安嘉泓机械设备有限公司（www.xajhjxsb.com）实力雄厚，信誉可靠，在陕西西安的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领嘉泓机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sxycxhpj.com）还是从事陕西预成型焊片设备生产，深圳预成型焊片设备厂家，郑州预成

型焊片设研制的厂家，欢迎来电咨询。